



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20070403001

2007 年 9 月 12 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 

デジタルアイソレータ IS072x製品 組立サイト追加変更のご案内

(初版 PCN20070403001 2007 年 4 月 26 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	デジタルアイソレータ IS072x 製品 組立サイト追加変更 現行 : TI-Taiwan(台湾) 変更後: TI-Taiwan(台湾) 及び HANA 社(タイランド)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	10 月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) デジタルアイソレータ IS072x製品について、現行 TI-Taiwan (台湾) にて製造いたしておりますが、これに加えHANA社(タイランド)を組立サイトとして下記製品部材を追加し認定しました。尚、出荷梱包部材につきましては、追加認定したサイトで現在使用しております部材の使用とさせていただきます。

変更内容	現行	変更後
製造サイト	TI-Taiwan (台湾)	TI-Taiwan (台湾) HANA社(タイランド)
マウントコンパウンド	HITACHI EN4088Z	HITACHI EN4088Z ABLESTIK 2200D
モールドコンパウンド	LOCTITE GR825-73B	LOCTITE GR825-73B SUMITOMO EME-G600

理由：供給能力の確保の為

対象製品リスト

対象製品名			
IS0721D	IS0721MD	IS0722D	IS0722MD
IS0721DG4	IS0721MDG4	IS0722DG4	IS0722MDG4
IS0721DR	IS0721MDR	IS0722DR	IS0722MDR
IS0721DRG4	IS0721MDRG4	IS0722DRG4	IS0722MDRG4

製品表示

製造サイト追加に伴い、製品表示の製造サイトを示すコード(下線“S”の部分)が、“T” (TI-Taiwan) に加え、“T” 及び“H” (HANA 社：タイランド)となる予定です。

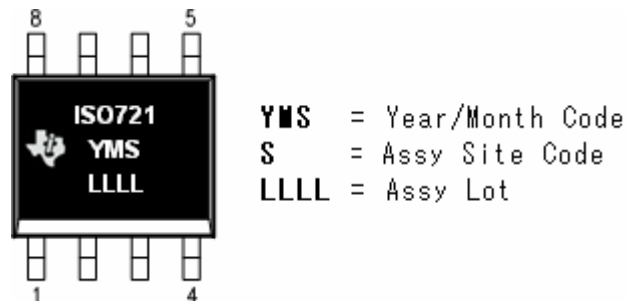


図 1 製品表示の例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2007 年 9 月 4 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	IS0721D	IS0721MD		
Die Name:	BLBFISO721RCC	BLBFIS721MRCC		
Die Revision/ Size (mils):	C / 29 x 76	C / 29 x 76		
Wafer Fab Site/ Fab Process:	DFAB / LBC4 (BOAC)	DFAB / LBC4 (BOAC)		
Assembly Site:	Hana (HNT)	Hana (HNT)		
Package / Pin Count:	D / 8	D / 8		
Mold Compound:	SUM EME-G600	SUM EME-G600		
Die OverCoat:	None/ BCB	None / BCB		
Mount Compound:	ABL 2200D	ABL 2200D		
Bond Wire:	TS-0.95 Au	TS-0.95 Au		
Leadframe Material/ Finish:	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu		
Moisture Sensitivity Level:	L1-260C	L1-260C		
Flammability Rating:	UL 94 V-0	UL 94 V-0		
Inter-Chip Bonds:	Yes	Yes		
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		IS0721D		IS0721MD
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test,	150C,300hrs	114/0	115/0	116/0
**HAST	130C/85%RH ,96 hrs	77/0	77/0	77/0
**High Temp Storage	170C,420hrs	77/0	76/0	77/0
**Temp Cycle,	-65/150C ,1000cys	-	-	77/0
**Thermal Shock	-65/150C ,1000cys	-	-	77/0
**Autoclave	121C /240hrs	-	-	77/0
ESD	MM: 200V	3/0	-	3/0
	CDM: 1500V	3/0	-	3/0
Characterization	Per Products Spec	Complete	-	Complete
Solderability	8hrs Steam Age	22/0	22/0	22/0
Lead Fatigue	Per Spec	22/0	22/0	22/0
Lead Pull	Per Spec	22/0	22/0	22/0
Lead Finish Adhesion	Per Spec	15/0	15/0	15/0
Physical Dimension	Per Spec	5/0	10/0	5/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
	UL-1694	5/0	5/0	5/0
Bond Strength	Per Assembly Site spec (Wires)	76/0	76/0	76/0
Die Shear	Per Assembly Site spec	11/0	11/0	11/0
X-Ray Inspection	Per Assembly Site spec	Pass	Pass	Pass
Manufacturability	Per Assembly Site spec	Approved	Approved	Approved
Visual/Mechanical	Per Spec	Approved	Approved	Approved
Moisture Sensitivity (JEDEC)	L1/260C	12/0	-	12/0
Preconditioning Information: ** Preconditioning sequence: Level 2 -260C (HIR)				